

2026年6月2日
TOPPAN 株式会社

TOPPAN、「電子機器トータルソリューション展 2026」に出展
半導体の高機能化を牽引する FC-BGA 基板や
大型ガラスパネルを活用した次世代半導体パッケージ部材を紹介

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:野口 晴彦、以下 TOPPAN)は、2026年6月10日(水)から12日(金)に開催される「電子機器トータルソリューション展 2026」(会場:東京ビッグサイト)に出展します。

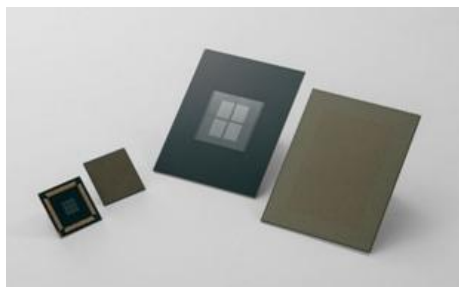
本展示会は、電子回路・実装技術や、センサー・ウェアラブル技術等の新しいコンテンツとソリューション等の展示に加え、技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界および関連業界全体の発展に寄与する、国内外に広く認知されている展示会です。

今回の TOPPAN ブースでは、「世界を駆ける、未来に架ける、TOPPAN の半導体パッケージソリューション」をテーマに、FC-BGA(Flip Chip-Ball Grid Array)基板をはじめ、次世代半導体パッケージ関連の技術や部材などの展示・紹介を行います。



■ 主な展示内容

・FC-BGA 基板

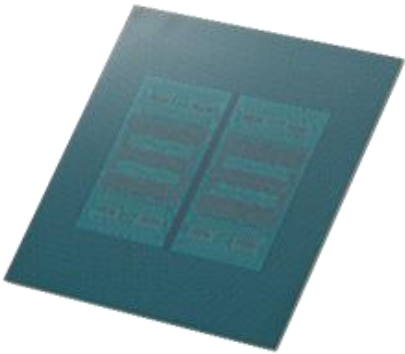


FC-BGA 基板は、LSI チップの高速化・多機能化を可能にする高密度半導体パッケージ基板です。ゲーム機から通信サーバー、車載 SoC まで幅広い分野で採用されています。

TOPPAN ブースでは、データセンターやネットワーク機器向けの先端 LSI 向けとして、チップレット構造に対応する大型 FC-BGA、および LSI と光デバイスの近接実装に対応する CPO (Co-Packaged Optics) 向け基板を展示します。

・次世代半導体パッケージ

① ガラスコア FC-BGA 基板



ガラスコア FC-BGA 基板は、チップレット技術に伴う基板の大型化に対し、剛性に優れたガラス材料をコア材に採用することで、最大の課題である「反り」を大幅に低減できる技術として期待されています。

TOPPAN は、実用化の障壁であったガラス特有の「背割れ」を、構造と加工技術の最適化により抑制し、次世代パッケージに求められる高い信頼性を備えた基板の実現に向け、開発を進めています。

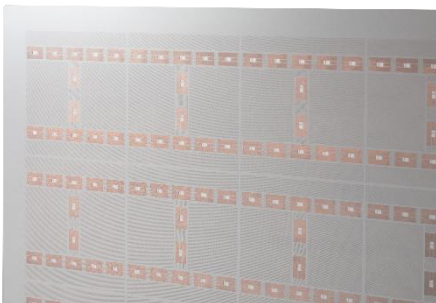
② ダマシンプロセス有機 RDL



ダマシンプロセス有機 RDL は、チップレット技術や 2.5D 実装といった次世代半導体パッケージにおいて、チップ間を高速・高密度に接続するインターポージャー等への活用が期待されています。

TOPPAN は、半導体前工程由来のダマシンプロセスを大型パネルサイズへ展開し、微細配線形成能力と優れた生産性を両立させることで、次世代のさらなる高密度化への要求に応える新たな製造プロセスの開発を進めています。

③ ガラスパネル基板



ガラスパネル基板は、FC-BGA 基板のコア基材やガラスインターポージャーといった次世代半導体パッケージへの活用が期待されています。

TOPPAN は、カラーフィルタ製造等で培った高度なガラス加工技術を応用し、高密度配線を支える TGV (Through Glass Via) に加え、深さの異なる Cavity を同一基板内に混在させた大型ガラスパネル基板の開発に成功しました。

■ 「電子機器トータルソリューション展 2026」について

- ・会期 : 2026年6月10日(水) - 12日(金)
- ・会場 : 東京ビッグサイト東展示棟
- ・主催 : 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)
- ・TOPPANブース: 東 1-3 ホール 3F-35

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上